**Technical Datasheet for PCB-No.: 9446-02** Date: 07.06.2022

PCB panel :  PCBs per panel : 0 pieces

Panel dimensions : 0.00 x 0.00 mm tolerance : +/- 0.2 mm

Panel separation :  

PCB dimensions : 301,71 x 301,71 mm tolerance : +/- 0.2 mm

Base material : FR4

PCB thickness : 1,59 mm tolerance : +/- 0.1 mm

Layer count : 8

Layer stack – multilayer : standard

PCB contour : rectangle

Copper outer layer : 35 µm min. trace width : 120 µm

Copper inner layer : 35 µm min. clearance : 200.00 µm

Hole count : 5857 pieces

Hole diameters count : 15 pieces

Min. hole diameter : 0,3 mm

Plugged vias : Ø : 0.00 mm

Blind via count : 0 pieces min. Ø :0.00 mm

from layer to layer :

Buried via count : 0 pieces min. Ø :0.00 mm

from layer to layer :

Gold-finger connector count : 0 pieces Overall length : 0.00 mm

Pressfit technology :

Electrical test :

Impedance check :

Test certificate :

Surface finish :  

SMD parts : top  bot Pad count: top 10387 bot 894

Solder mask : top  bot  Color: top green bot green

Silkscreen : top  bot Color: top white bot white

Comments (manufacturing notifications):

PCB Name / Title : mDOM\_mb

Layouter : Karl-Heinz Sulanke Phone.: 7207

Group :

Data files count : 0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datei Name | Bezeichnung | Kommentar |

Layer stackup:

1. (Xpedition -> Setup->Stackup Editor…->Edit->Copy Special->Manufacturing Documentation)
2. (Um den Stackup einfügen zu können, muss der Schutz in diesem Dokument zuerst aufgehoben werden)
3. (de: Überprüfen -> Bearbeitung einschränken -> Schutz aufheben)

(en: Rewiew -> Restrict Editing -> Stop Protection)